

Advanced PKG개발



#이천

#Expert+(10년차이상)

우리 조직을 소개합니다

HBM 선행 Tech 및 2.5D SiP/Fan-out WLP 등 선행 기술을 개발하고, PKG 미래 기술 Pathfinding을 주도합니다.

선발하고자 하는 직무는 이런 일을 합니다

① PKG R&D전략

- PKG 기술/제품 개발 전략 기획

미래 기술 변화에 대응하기 위한 PKG R&D 전략 수립 및 New Business Model을 기획/개발하고, Global R&D 파트너와 협력하며 해외 Adv. PKG Site를 구축하는 등 Beyond Memory Solution을 위한 PKG Pathfinding을 주도해요.

② PKG 선행공정

- Advanced Package 후공정 요소기술 개발

HBM 향 Hybrid Cu Bonding, New KGSD, Vertical Fan out, 2.5D SiP, CoWoS 후공정 개발 업무를 수행하며, PKG 미래 기술 대비를 위한 요소기술 개발 및 사전 기술 Feasibility 검증 업무를 수행해요.

③ PKG 선행TD

- HBM향 C2W Hybrid bonding 개발 Process Integration

MTS/PTS 기반 개발 완성도 확보 및 제품 개발 과제 기획과 제품 Design Rule 수립, 신뢰성 확보와 Hybrid bonding 핵심 요소 기술 개발 업무를 수행해요.

④ PKG 공정

- Advanced Package 2.5D SIP oS 공정기술 개발

Adv. PKG oS(on Substrate) 분야의 Bond, Lid attach, Unit SBM 요소기술 개발 및 Baseline Set-up 업무를 수행해요.

이런 분과 함께 하고 싶어요

학력 4년제 이상이며, 반도체, 전자, 전기, 물리, 기계 등 공학 계열의 전공자이신 분
반도체 유관 경력 10년 이상 보유자이면 좋아요 (석/박사 학위 수학 기간 경력 인정)

① PKG R&D 전략

- 반도체 유관 경력 15년 이상 보유자이면 좋아요.
- Global Ecosystem 파트너(대학/연구소, Fabless 고객, Foundry/OSAT) 협력 경험이 있으신 분
- PKG Technology Pathfinding 및 Open Innovation, System/PKG 설계 이력을 가지신 분
- New Business Model을 위한 PKG 기술 개발 경험이 있으신 분

② PKG 선행 공정

- Advanced PKG Back End 공정 개발 역량을 보유하신 분
- PKG N+3 미래 기술에 대한 이해도 및 기술 역량을 보유하신 분
- Pitch Scaling 측면 PKG 요소기술 개발 경험이 있으신 분

③ PKG 선행 TD

- Wafer Level Package 제품/공정 개발 관련 경험이 있으신 분
- Hybrid bonding 공정/제품 개발 경험이 있으신 분

④ PKG 공정

- Large Size PKG oS Bond 품질 확보 및 공정 개발 경험이 있으신 분
- Large Size PKG Lid attach 품질 확보 및 공정 개발 역량을 보유하신 분
- Large Size PKG Warpage 제어 및 공정 개발 역량을 보유하신 분

이런 경험이 있다면 더 환영합니다.

① PKG R&D 전략

- Global 업체 R&D 전략/기획 업무 수행 경험을 보유하신 분이면 좋아요
- 해외 대학/연구소/고객 협력 프로그램 참여 경험이 있으신 분
- 외국어로 원활한 소통이 가능하신 분

② PKG 선행 공정

- Conventional/Advanced PKG/Hybrid Bonding 공정 경험을 보유하신 분이면 좋아요
- 2.5D SiP CoWoS Large/Multi Die Bonding 요소기술 개발 경험이 있으신 분
- Data Science 역량 및 어학 능력이 우수하신 분

③ PKG 선행 TD

- HBM 공정/제품 개발 경험을 보유하고 있으시면 좋아요

④ PKG 공정

- 2.5D SiP oS 개발 및 양산 경험을 보유하신 분이면 좋아요